



平成 26 年 11 月 10 日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 新 川  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 長 野 高 志  
(コード番号 6274 東証第一部)  
問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 執 行 役 員  
経 営 企 画 部 長 兼 経 理 部 長 森 琢 也  
(電話番号 042-560-4848)

## 平成 27 年 3 月期第 3 四半期（累計）連結業績予想に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 27 年 3 月期第 3 四半期（累計）連結業績予想を下記の通りお知らせいたします。

### 記

平成 27 年 3 月期第 3 四半期（累計）連結業績予想数値（平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期 純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	—	—	—	—	—
今 回 修 正 予 想 (B)	7,600	△2,350	△2,080	△2,090	△115.00
増 減 額 (B-A)	—	—	—	—	—
増 減 率 (%)	—	—	—	—	—
(ご参考) 前期第 3 四半期実績 (平成 26 年 3 月期第 3 四半期)	5,899	△2,888	△2,651	△1,199	△65.95

### 業績予想の概要

半導体業界では、クラウドコンピューティングの普及に伴い、グラフィックスデバイスやサーバー向けとなるメモリ積層品の量産時期が近付いたことから、先端設備投資の機運が再び高まっています。

このような状況のもと、当社グループは、新製品群の拡販に加え、新体制によるグローバル・オペレーションの定着や外部パートナーとのアライアンスを活用した研究開発の推進など、グローバル競争力強化の取り組みを継続しています。

一方で、足元の景況としては、スマートフォン新製品生産の先行き不透明感や、PC の買い替え需要の一巡による余剰感が強まっていることなどから、半導体メーカー各社の設備投資は調整局面が続くと予想されています。

直近の受注状況など、現時点において当社グループが把握する情報に基づき、第 3 四半期連結累計期間の業績予想を開示します。

なお、為替の想定換算レートは、105円/米ドルです。

※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社グループとして約束する趣旨のものではありません。また実際の業績等は、様々な要因により、本資料における記述と大きく異なる可能性があります。

以 上